

La tendencia a la miniaturización en las demandadas aplicaciones de conexiones cable a placa

Artículo cedido por Arrow Iberia



info@arrowiberia.com
www.arroweurope.com

Los proveedores de sistemas de conexión suelen responder al desarrollo de encapsulados cada vez más compactos en la industria electrónica con gamas de productos con pasos más estrechos. Esta tendencia hacia la miniaturización es especialmente fuerte en las conexiones placa a placa de aplicaciones demandadas por la industria, sectores de instrumentación y equipos médicos.

Como resultado han aparecido algunas gamas de interconexiones placa a placa modulares en miniatura. Partiendo del estándar de 2,54 mm del mercado, los pasos se han ido reduciendo a 2,00 mm, y ahora se ofrecen cada vez más sistemas con productos de 1,27 mm de paso para aplicaciones con escaso espacio en la placa.

La estrategia del fabricante FCI ha sido siempre adelantarse a esta tendencia incorporando muchos

productos nuevos a su amplia cartera de conexiones placa a placa modulares. FCI se compromete con 'aplicaciones exigentes', basándose en tecnologías de conexión probadas, tales como los sistemas de contacto de haz dual, con capacidad de aguantar temperaturas de funcionamiento de hasta 125 °C.

Con respecto a las conexiones cable a placa, la tendencia de miniaturización, impulsada por la industria automovilística, siempre se ha visto limitada a los sistemas de cables de cinta planos. Varios sistemas de interconexión con paso de 1,27 mm, basados en la tecnología IDC simple y fiable, están disponibles.

La interconexión de cables discretos es otra historia: los diseñadores no querían saber nada de los sistemas de conexiones crimpadas de cables con un paso de 1,25 mm que existen en el merca-

do, porque estos se han diseñado principalmente para la electrónica de consumo. Generalmente consideran que las interconexiones de productos de consumo no pueden cumplir los criterios 'exigentes' y básicos en cuanto a temperaturas de funcionamiento, coplanaridad y estabilidad dimensional, etc. (carcasas sin nailon).

Para cubrir la creciente demanda de interconexiones cable a placa con paso reducido, FCI ha presentado un sistema de conexión cable a placa de 1,25 mm de paso que cumple los requisitos de las 'aplicaciones exigentes', lo que da por resultado una serie de terminales, cajas de empalme y cabezales PCB de montaje recto, rectangular, en superficie y a través de agujero pasante en una gama de 2 a 15 contactos por conector. La incorporación de este sistema de conexión cable a placa con un paso de 1,25 mm a la actual cartera de conexiones placa a placa con pasos de 2,54 mm, 2,00 mm y 1,27 mm ofrece a los clientes más opciones de una gama de productos estándares probados.

A diferencia de muchos otros productos previstos para las mismas aplicaciones, el sistema de conexión cable a placa con paso de 1,25 mm de FCI cumple las normas industriales de seguridad de la UE, y el cabezal PCB está hecho de un material libre de halógenos. Los productos se han fabricado con un material de LCP de forma estable y aguantan temperaturas desde los -40 °C hasta los 105 °C, lo que supone la mayor resistencia térmica de conexiones cable a placa con paso de 1,25 mm de la industria. También se ofrecen herramientas crimpadoras para arneses de cables.

Si desea visitar la nueva página de este producto de FCI siga el enlace:

<http://www.arroweurope.com/fci/1.25mmwtb>

